



2021年12月8日

各 位

会 社 名 株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者 取締役社長 石井 常路
(コード番号 6125 東証 第二部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員
管理本部長 高橋 正弥
(TEL. 027-385-5800)

(差替)「2022年3月期第2四半期決算説明資料」の差替えについて

2021年12月7日に開示いたしました「2022年3月期第2四半期決算説明資料」の記載内容の一部に修正すべき事項がございましたので、別紙の通り再度開示いたします。


以 上



Okamoto

株式会社岡本工作機械製作所
(証券コード:6125)

2022年3月期第2四半期決算説明資料

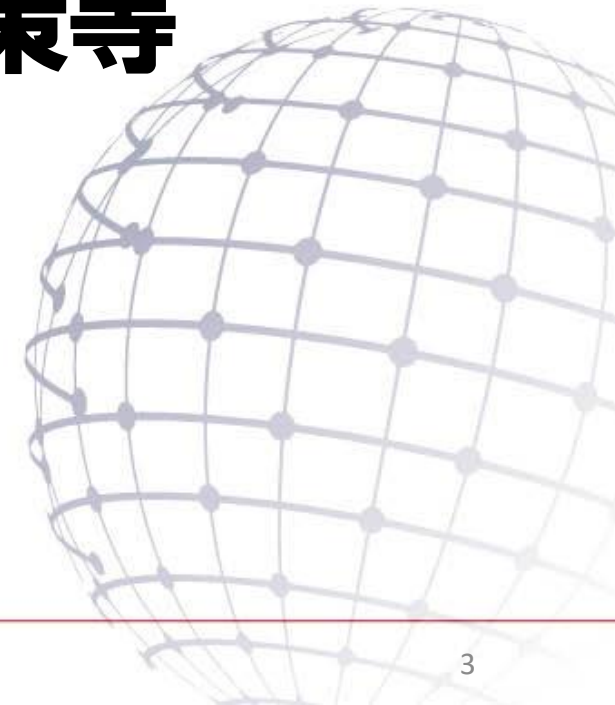


2021年12月7日

1. 新型コロナウイルス感染症の影響、当社施策等
2. 2022年3月期 第2四半期 決算概況
3. 2022年3月期 通期決算予想
4. 半導体関連装置 事業概要と足元の状況
5. 中期経営計画の進捗と今期施策
6. トピックス EV関連領域での当社製品の役割

Appendix 当社製品の各分野での役割

1. 新型コロナウイルス感染症の影響 感染症への当社施策等

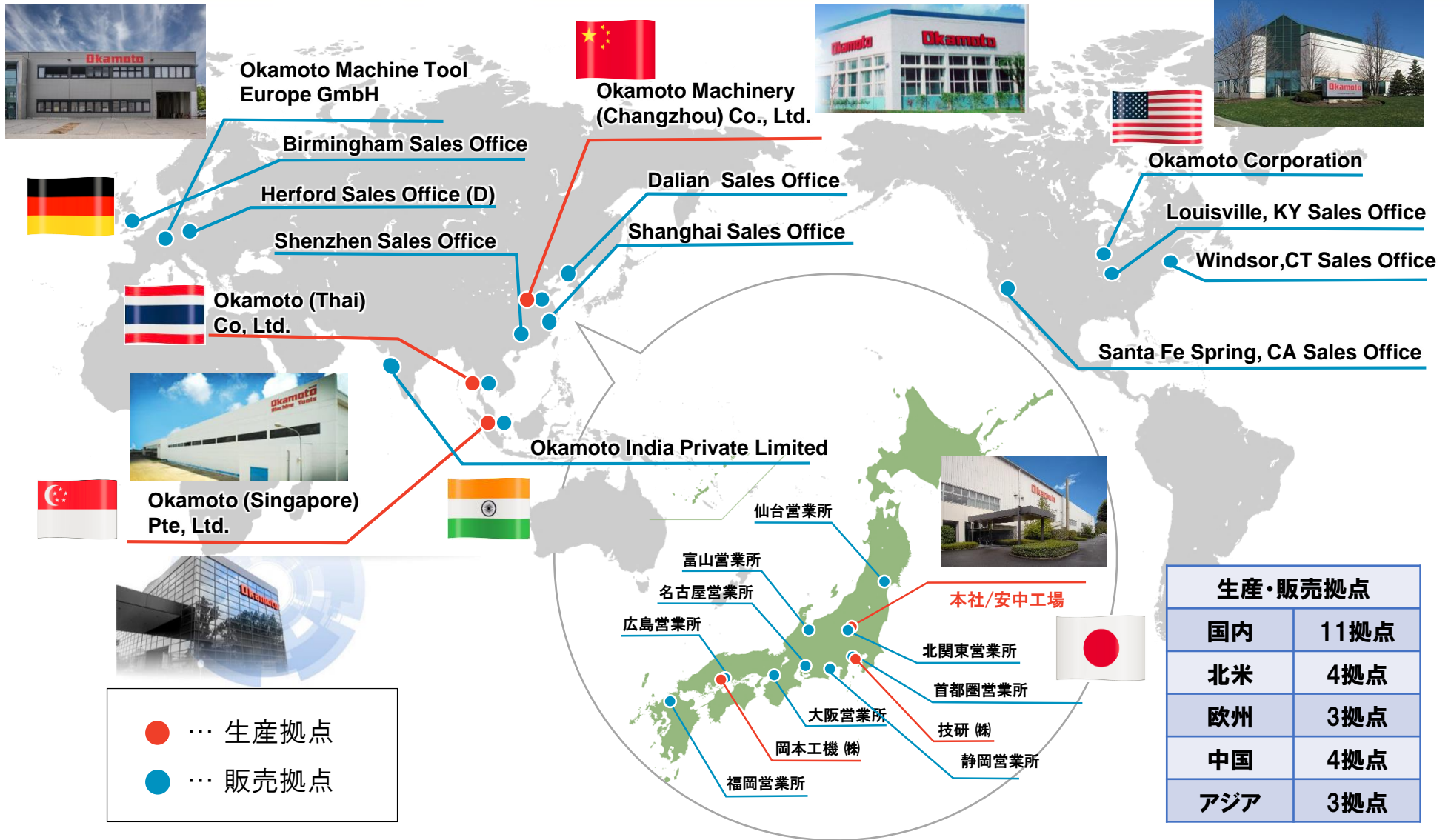


新型コロナウイルス感染症にかかる当社内部施策（防疫対策）

引き続き従業員の健康を第一に考え、その上での安定的な操業を目指して防疫対策を徹底中

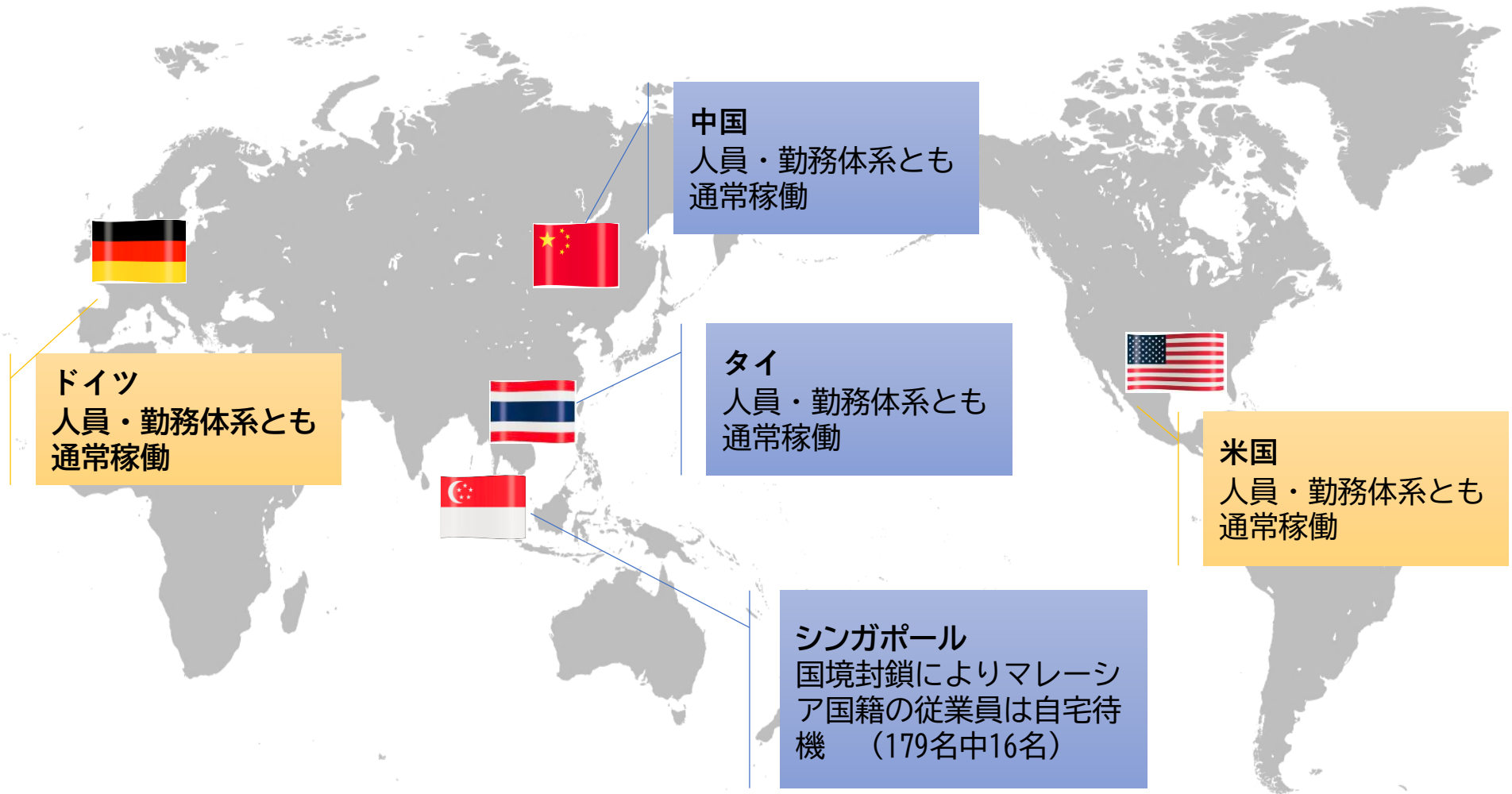
項目	該当拠点
入社時の検温、発熱時・体調不良時の自宅待機	全拠点
在宅勤務、時差出勤等	全拠点
テレビ会議システムの活用	全拠点
帰国従業員の自宅待機、会議の縮小	国内全拠点
食堂、工場などレイアウト変更、主要箇所定期消毒	全拠点
従業員に対するマスク配布と着用の徹底	全拠点
来場者入場時の検温と入退出管理の実施	全拠点

国内拠点、海外拠点



新型コロナウイルス感染症にかかる海外各拠点の状況（11月16日時点）

ワクチン接種の進展等を受け、各拠点とも対策を施しながらも、ほぼ通常稼働に



withコロナの営業活動展開 ①

コロナ禍の中、オンラインの活用やWebサイトを通じた製品紹介など
withコロナの時代の営業スタイルが進展。afterコロナの時代にも通じる効率的な営業を模索



WEB限定特販機会場

岡本工作機械製作所では、展示会に出展した研削盤や各ショールームで展示されている研削盤を【特販機】にて販売を行っております。

[詳しくはこちら >](#)



withコロナの営業活動展開 ②



オンラインを活用した
打合せ・テスト研削実施中

← 弊社工場へ来社不要！詳しくは、OKAMOTO担当営業
までお気軽にお尋ねください！

詳しくはこちら >



各種カタログダウンロード

← 各種カタログがダウンロードできます。これより先は株
式会社アヘルザの外部サイトへ移動します。

詳しくはこちら >

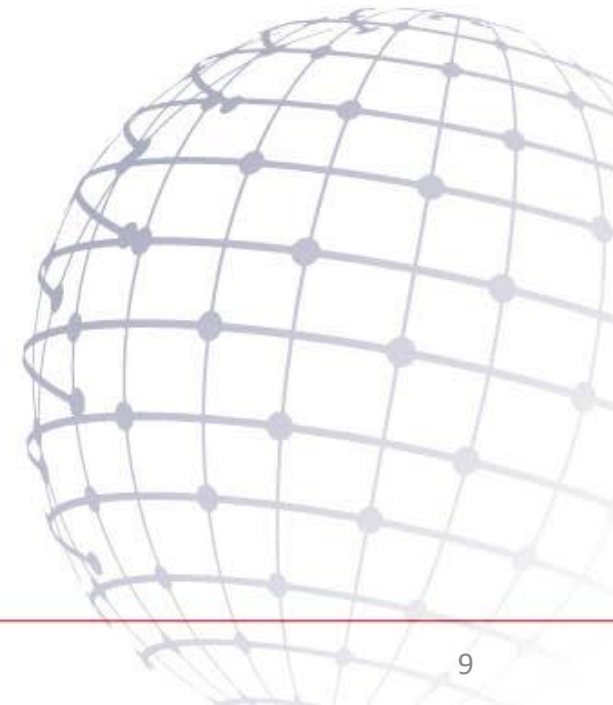


製品・技術動画

製品・技術に関する動画コンテンツの一覧を確認することができます。

詳しくはこちら >

2. 2022年3月期第2四半期決算概況



■国内市場

- 工作機械はモノづくり補助金や事業再構築補助金などの経済政策や好調な半導体業界からの需要を背景に市場の回復が続き売上は堅調に推移。受注については半導体関連を中心に幅広い業界から大型平面研削盤、内面研削盤、汎用平面研削盤などの注文を受け好調に推移し、前年同期を上回る。
- 半導体については、5Gスマートフォンの需要増加や新型コロナウイルスの影響で定着した在宅勤務・オンライン授業の広がりからパソコン、データセンター関連向けの半導体デバイスの需要が引き続き堅調。売上もファイナルポリッシャーの販売増加などが寄与し、好調に推移。また、半導体業界の設備投資意欲の継続から、複数の取引先から半導体製造装置の大口受注を獲得。

■ 海外市場

- 北米市場は、好調なセラミックス業界や金型業界向けの需要が継続、受注は成型研削盤や汎用平面研削盤などの受注が貢献し、前年同期を大きく上回る。売上も好調な受注を反映し、前年同期を上回る。
- 欧州市場は、ワクチン接種の普及による経済活動の再開や自動車産業の設備投資意欲上昇から、EV関連向けを中心に精密平面研削盤や汎用平面研削盤の需要が高まり受注好調。
- アジアについては、中国は前年より引き続きEV関連が好調なほか、半導体や5G関連投資が活発で小型研削盤や汎用平面研削盤の需要が拡大、売上・受注とも好調。東南アジアでも設備投資意欲が回復、受注は前年同期を大きく上回る。

米国、中国での取り組み

米国

- ◆ ワクチン接種進み本格的経済再開による設備投資意欲の回復により、上期受注は好調
- ◆ 好調な半導体、医療、セラミックス関連へ門型・円筒・内研・ロータリー研削盤の拡販継続
- ◆ 海上輸送問題による納期遅延解消できず、下期については在庫機販売に注力し売上確保
- ◆ 輸送費、オプションの価格高騰に対し販売価格の値上げで利益を確保する



中国

- ◆ 半導体の自給自足に向けた取り組みを追い風に、中・大型機・自動化提案での販売強化
- ◆ EV化が加速しており、Tダイやモーターコア関連に焦点を絞り拡販を継続
- ◆ カスタマーチームによるソリューション提供の強化を行う
- ◆ 小型成形研削盤の現地生産を強化し、利益率アップを図る



業績ハイライト

* 「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期連結会計期間の期首より適用前第2四半期連結累計期間との増減額及び前年同期比（%）は記載せず

（単位：百万円）

	2020年9月	2021年9月
	金額	金額
売上高	13,799	17,190
売上総利益	3,645	5,144
販売費及び一般管理費	3,180	3,660
営業利益	464	1,483
経常利益	497	1,596
当期純利益	350	1,178

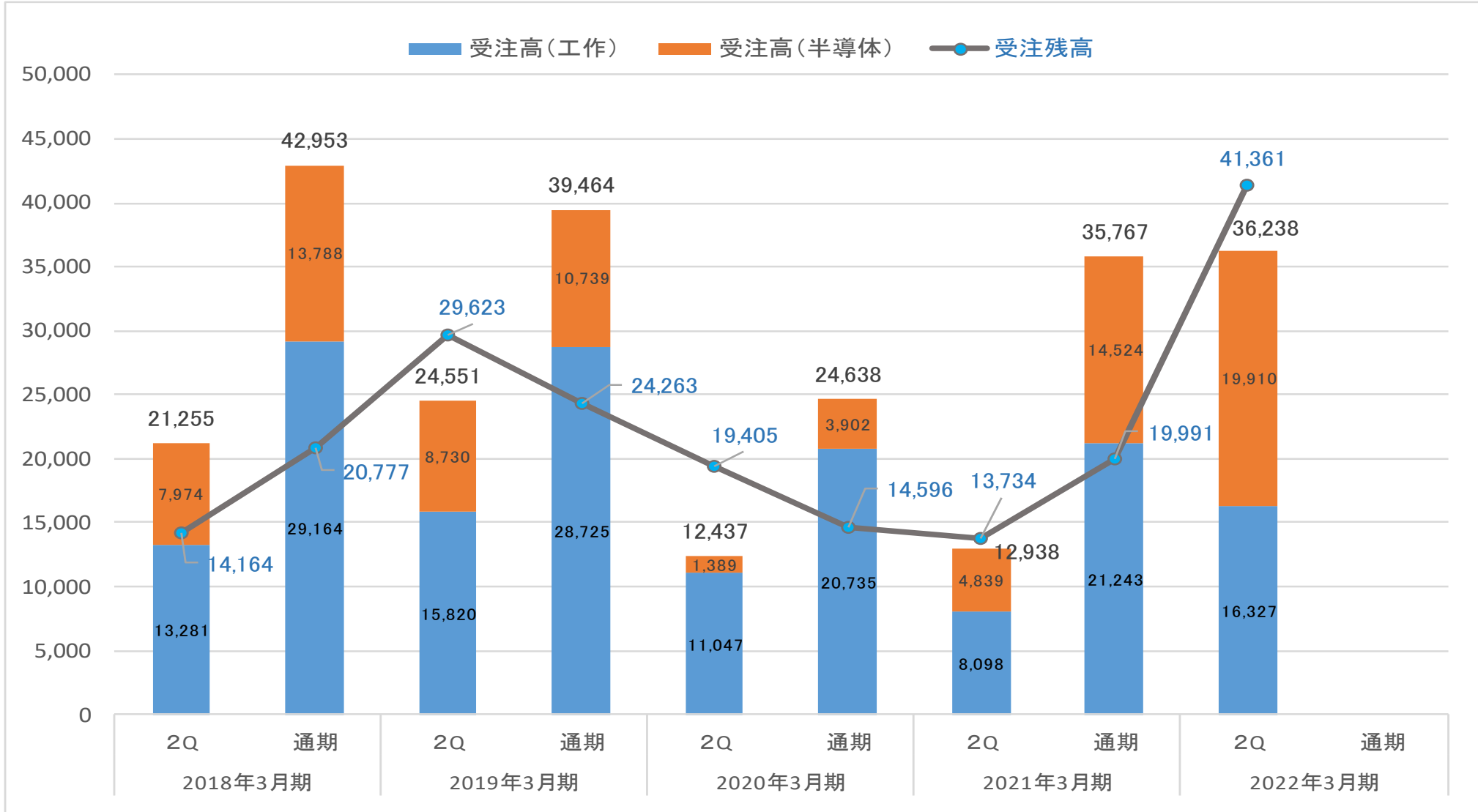
（単位：百万円）

	2021年3月	2022年3月 (予想)
	金額	金額
設備投資額	946	2,132
減価償却費	1,367	1,382
研究開発費	115	146
為替レート	2020年9月	2021年9月
米ドル	106.32	110.10
シンガポールドル	76.67	82.01
ユーロ	121.66	131.16
タイバーツ	3.37	3.41
人民元	15.20	17.07

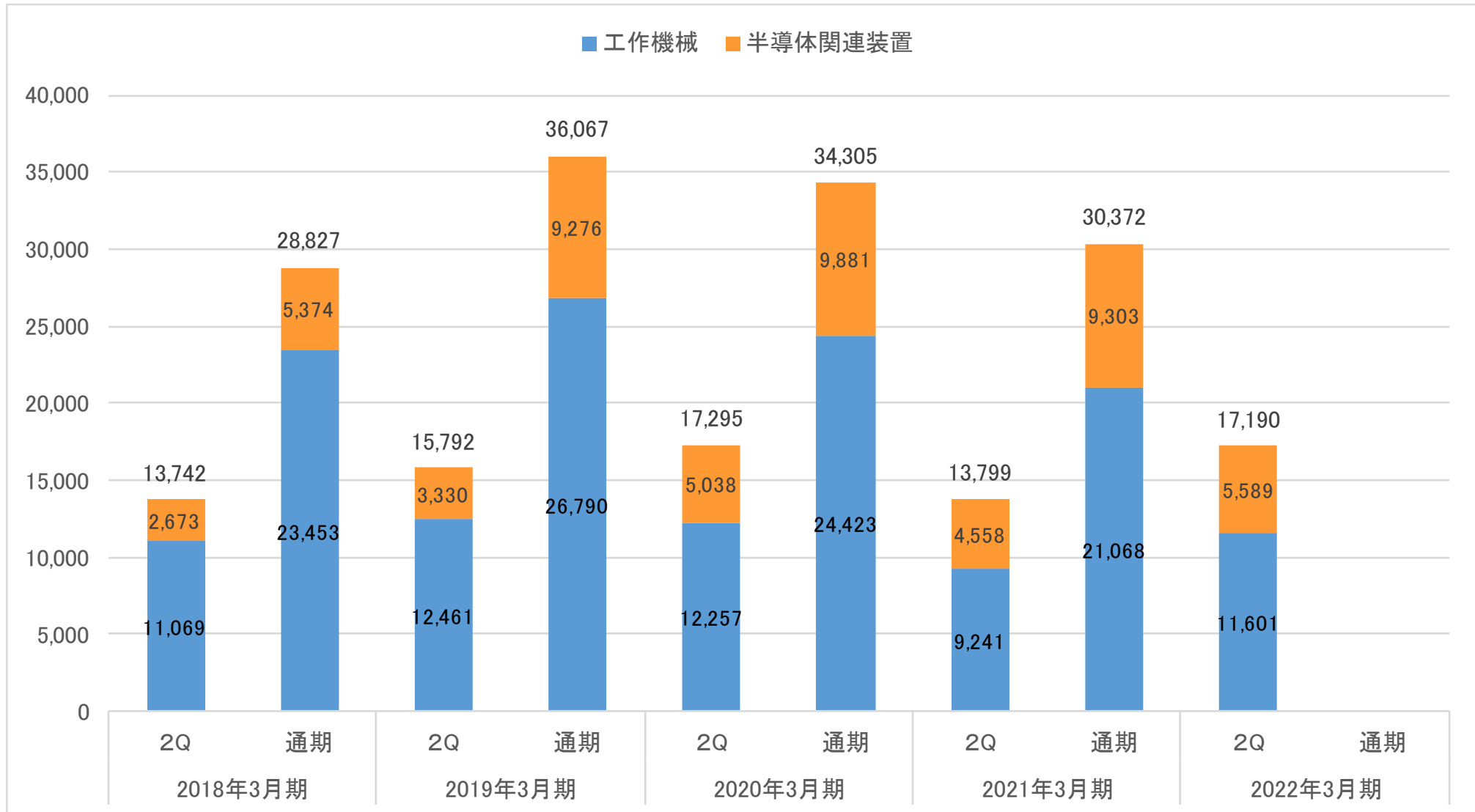
※期中の平均レートで記載しております。

- 売上高は171億9千万円（昨年上期は137億99百万円）、営業利益は14億83百万円（前期は4億64百万円）
- 工作機械は補助金による経済政策などの寄与で受注は回復傾向、売上については歯車・鋳物が好調
- 半導体は好調な受注を背景に海外売上が増加、前年を上回る実績。受注は大口受注を獲得

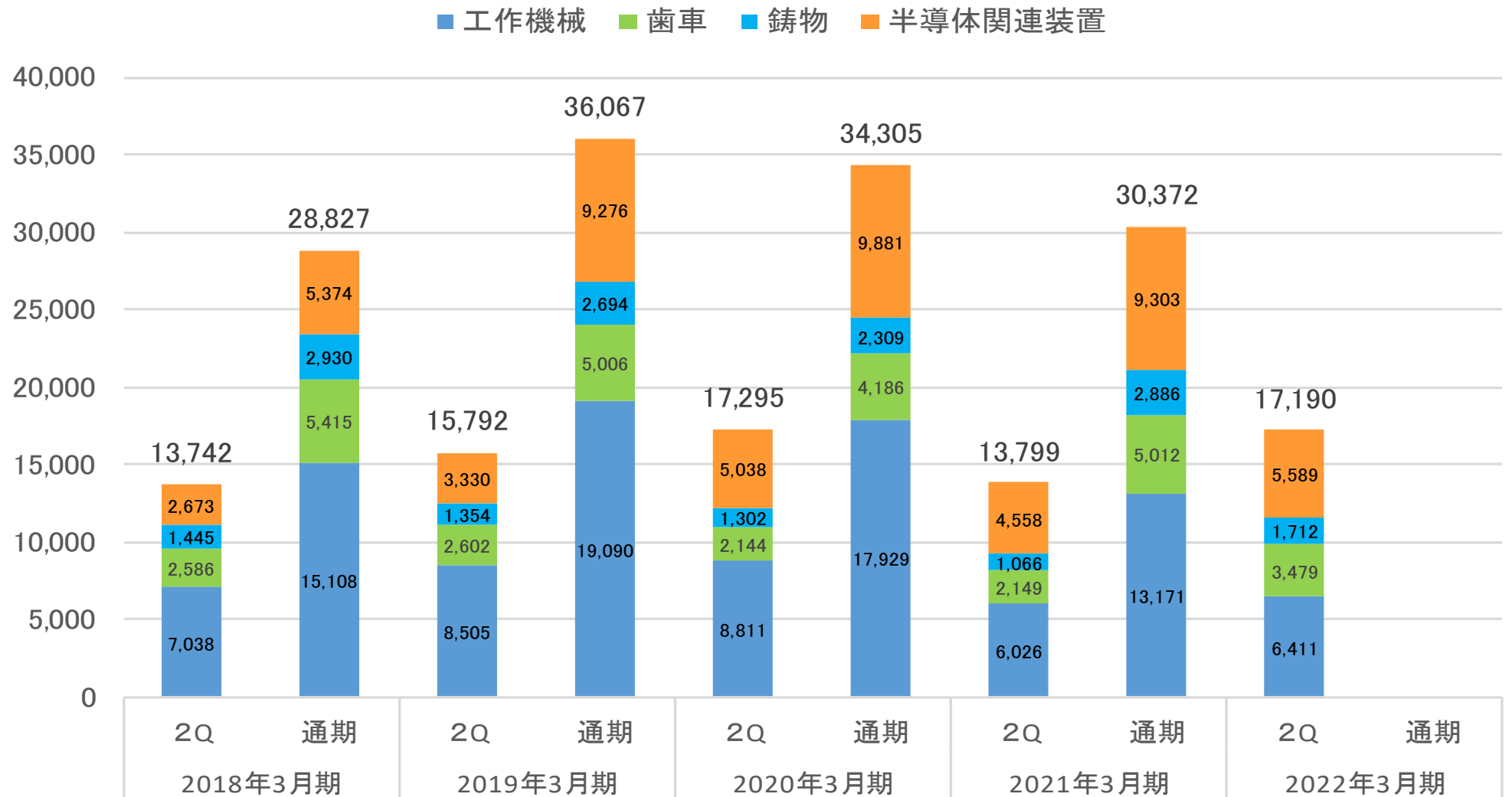
受注・受注残高



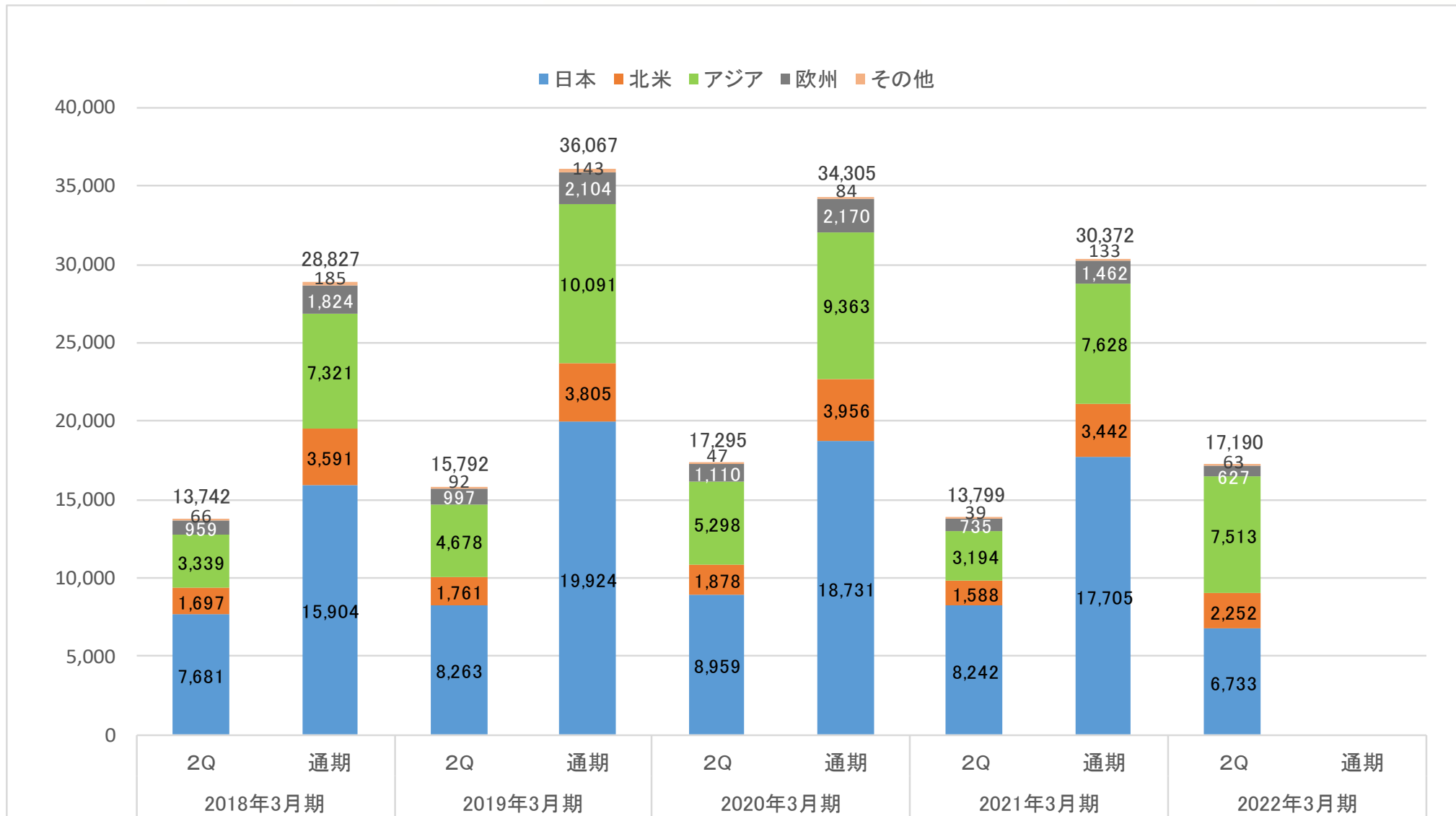
セグメント別売上高推移①



セグメント別売上高推移②



エリア別売上高推移



比較貸借対照表

(単位：百万円)

	2021年3月		2021年9月	
	金額	金額	金額	対前期末比
流動資産	23,444	27,425		+3,981
現金及び預金	4,925	8,173		+3,248
受取手形及び売掛金	9,391	7,221	▲	2,170
棚卸資産	8,987	11,577		+2,590
有形・無形固定資産	9,952	9,625	▲	327
投資等	1,653	1,708		+55
資産合計	35,050	38,758		+3,708

(単位：百万円)

	2021年3月		2021年9月	
	金額	金額	金額	対前期末比
負債合計	19,969	23,316		+3,347
流動負債	16,832	20,634		+3,802
固定負債	3,137	2,682	▲	455
純資産合計	15,080	15,442		+362
負債資本合計	35,050	38,758		+3,708

比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2020年9月	2021年9月	
	金額	金額	対前年同期比増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,172	8,363	+5,191
税引前当期純利益	497	1,596	1,099
減価償却費	677	667	▲10
売上債権の増減（▲は増加）	1,637	1,156	▲481
棚卸資産の増減（▲は増加）	908	▲1,077	▲1,985
仕入債務の増減（▲は減少）	▲591	999	+1,590
その他	44	5,022	+4,978
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲442	▲270	+172
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲2,519	▲4,815	▲2,296
換算差額	13	▲28	▲41
現金・現金同等物残高	3,537	8,028	+4,491

3. 2022年3月期 通期決算予想



2022年3月期の市場環境見通し

■ 国内市場

- 工作機械はものづくり補助金や事業再構築補助金など新型コロナウイルス感染症後の速やかな景気回復に資する政府施策の動向などを注視し、需要の掘り起こしに努めるほか、半導体業界や工作機械業界など上期に引き続き好調な業界の設備投資増加を予想
- 半導体については、5Gや在宅勤務、オンライン授業の定着・広がりを背景に引き続き活発な設備投資を予想

■ 海外市場

- 北米市場は、コロナ後の景気回復を受け、引き続きセラミックス業界や金型業界の好調を予想も、海上輸送などロジ関係の問題、価格高騰への対処などの課題も
- 欧州はコロナ感染症の再拡大はあるものの、自動車産業などの設備投資増加を予想
- アジア市場では引き続き中国でのEV関連、半導体関連など国産化の加速に伴う設備投資の増加を予想。東アジア、東南アジアでも半導体関連を中心に投資の増加を予想

通期業績予想

引き続き半導体関連装置が業績を牽引、回復傾向にある工作機械が補い
売上高340億円、経常利益27億円の達成を見込む

* 「収益認識に関する会計基準」等を第1四半期連結会計期間の期首より適用
前2021年3月期との増減額及び前年同期比（%）は記載せず

(単位：百万円)

	2021年3月期	2022年3月期 (予想)
	金額	金額
売上高	30,372	34,000
売上総利益	8,494	10,340
販管費	6,588	7,590
営業利益	1,905	2,750
経常利益	1,869	2,700
当期純利益	1,458	2,000

(単位：百万円)

	2021年3月期	2022年3月期 (予定)
	金額	金額
設備投資額	946	2,132
減価償却費	1,367	1,382
研究開発費	115	146

為替レート	2021年3月期	2022年3月期 (予想)
米ドル	105.94	109.00
シンガポールドル	77.76	80.00
ユーロ	124.07	121.00
タイバーツ	3.42	3.60
人民元	15.56	15.60

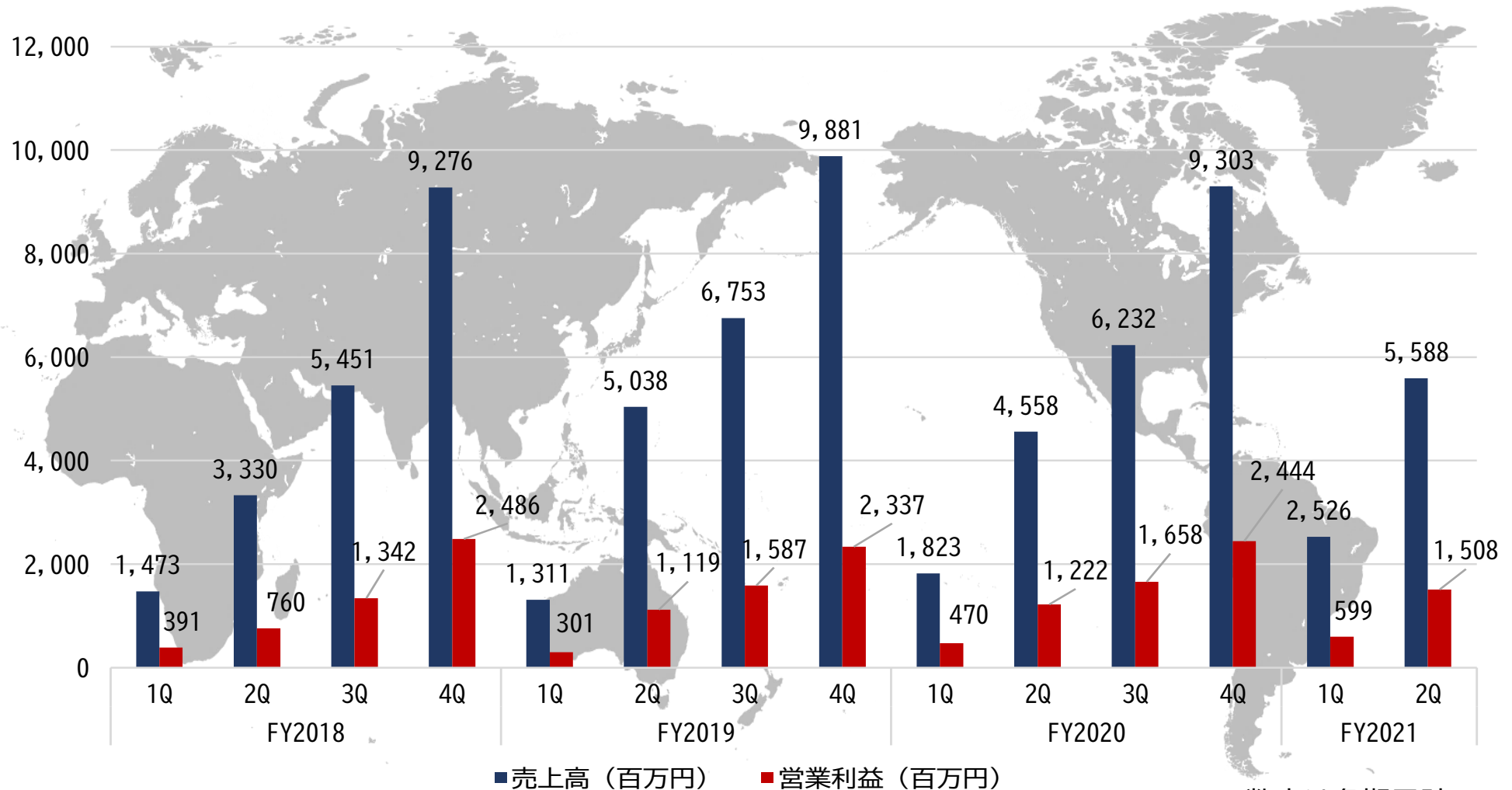
※期中の平均レートで記載しております。

4. 半導体関連装置 事業概要と足元の状況



半導体関連装置 売上高・セグメント（営業）利益推移 FY2018～

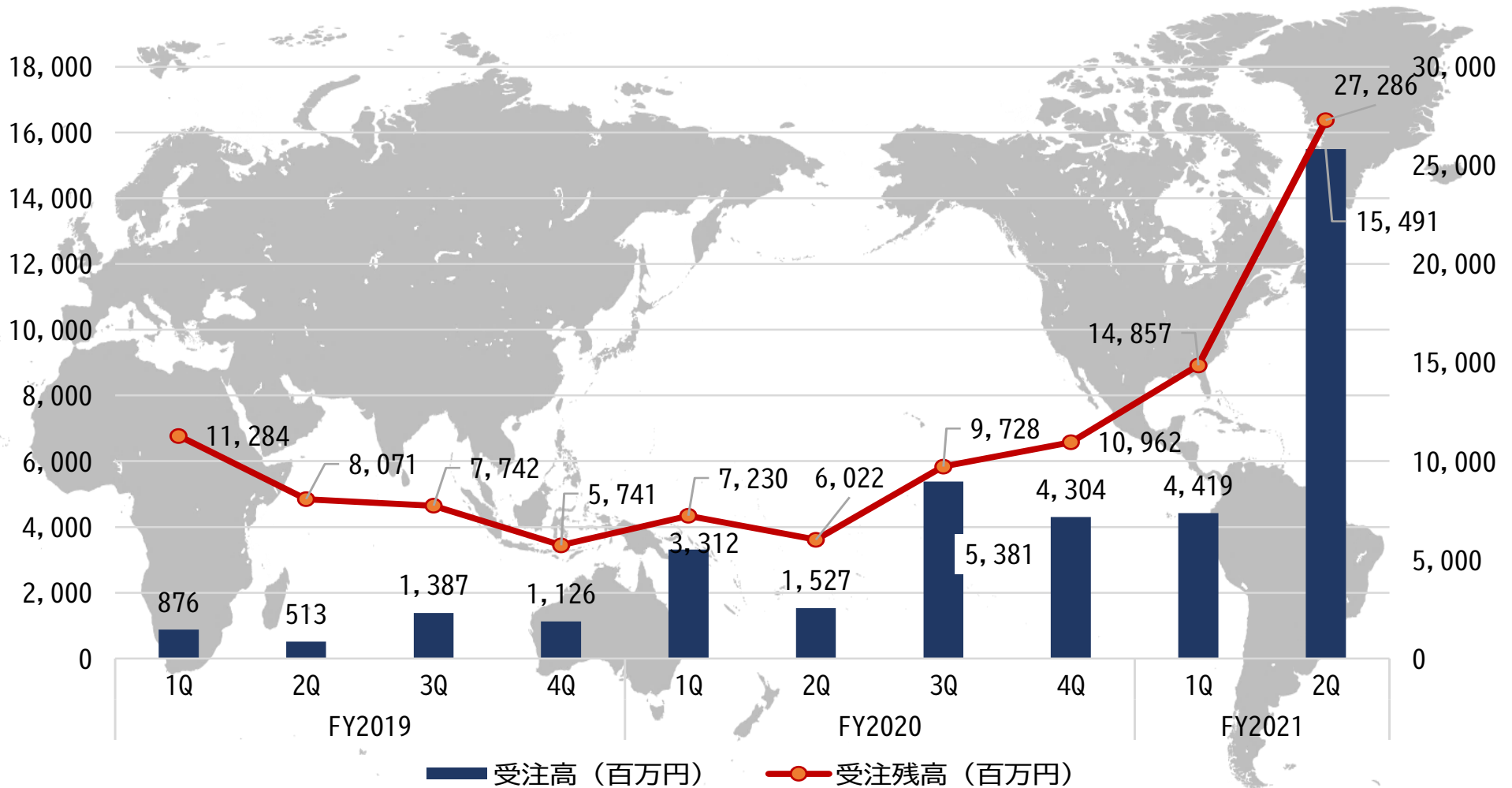
半導体関連装置は好調さを維持、業績を下支え中計目標「安定した収益を確保できる企業」に貢献



数字は各期累計

半導体関連装置 受注高・受注残高推移

当第2四半期で複数の顧客から大口受注を獲得、受注残高も272億86百万円に



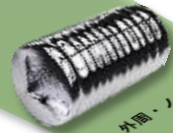
シリコンウェーハの製造工程

スライシング、ラッピング、エッチング、ポリッシングと流れるウェーハ加工工程の中で
 ポリッシング工程で主力機種PNXシリーズなどでファイナルポリッシャーで高いシェアを誇る

半導体シリコン材料工程

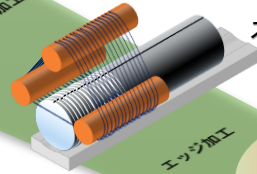


単結晶引き上げ (CZ法)



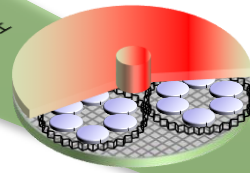
単結晶シリコンインゴット

外周・ノッチ加工



スライス加工

エッジ加工



ラップ加工

12" 対応高精度ウェーハ研削盤

研削加工



12" ウェーハ用



SVG 201D300



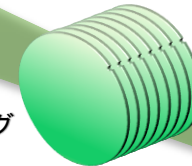
GNX 312



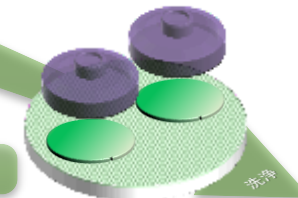
GNX 201D300



エッチング



ファイナルポリッシュ (CMP)



🔧 ファイナルポリッシャーPN332B

- 300mmファイナルポリッシャーのベストセラー
- 3テーブルあるポリッシュステージで、中研磨から仕上げ研磨まで1テーブルあたり2枚同時研磨することで、装置1台あたり6枚のウェーハを同時研磨可能
- インデックス搬送方式採用のため残り2ヘッドでウェーハのロード/アンロードが可能となり、高生産を実現



今後の取り組み

技術面ではシリコン以外の特殊材料向け高能率機器の開発や積層化への対応を強める

販売面での取り組み

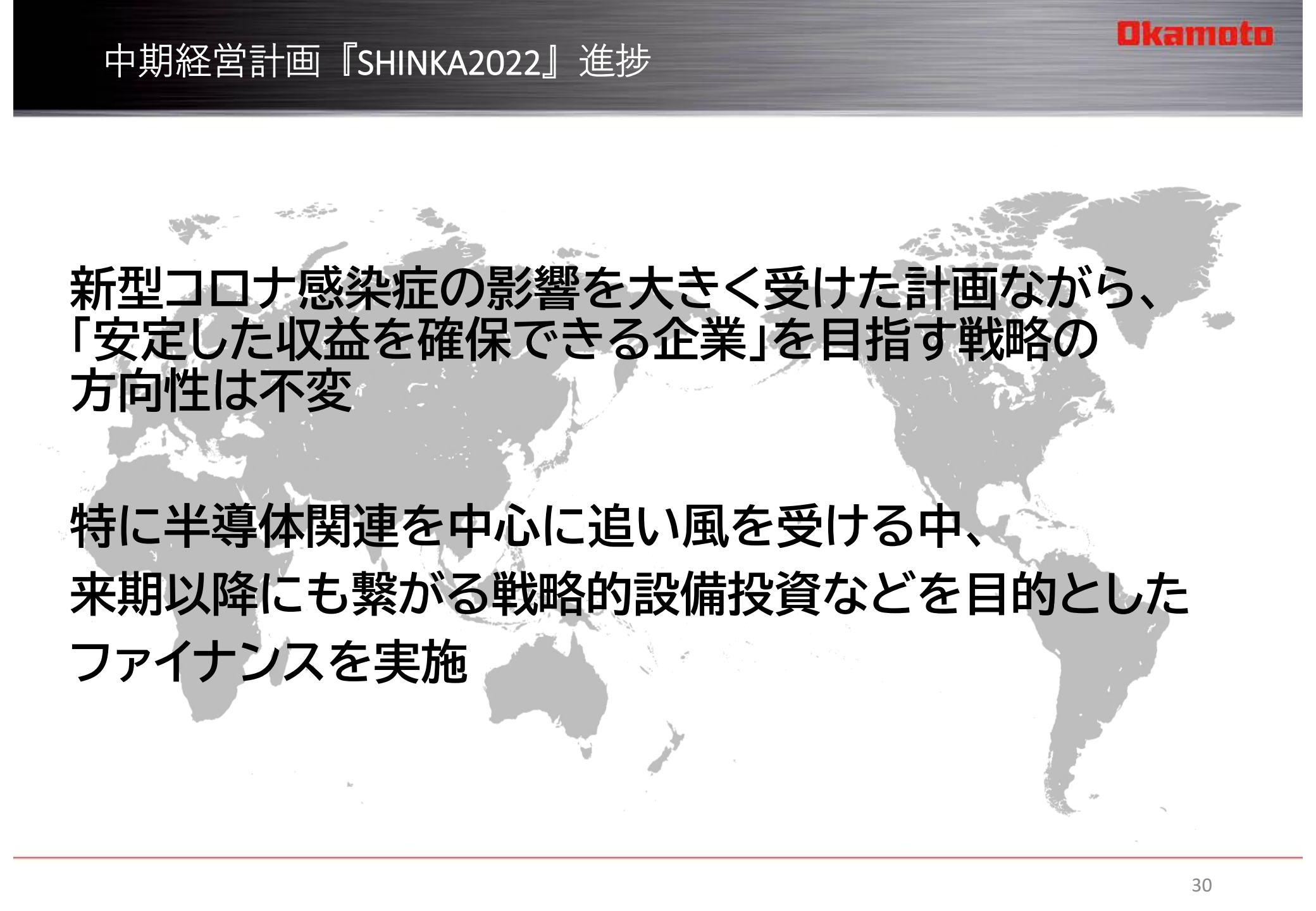
- ・ プロセスを含めたサポート体制を強化
- ・ WLP（ウェーハレベルパッケージ） / PLP（パネルレベルパッケージ）用研削盤の市場投入

技術面での取り組み

- ・ 市場が拡大しているパワーデバイス関連材料であるSiC、GaN、スマートフォンに採用されているSAWフィルター用のLT（タンタル酸リチウム）やLN（ニオブ酸リチウム）など、特殊材料向け専用の高能率研削盤やラップ盤・ポリッシュ盤の開発強化
- ・ 半導体の積層化に係るSi貫通電極ウェーハの低コスト化、超平坦化、金属汚染フリー、薄化加工の技術開発（JST採用のSi貫通電極ウェーハ自動薄化装置の開発継続）
- ・ 車載向けGPU（画像処理）に広く使用されているパッケージ基板用研削盤の開発の強化

5. 中期経営計画の進捗と今期施策



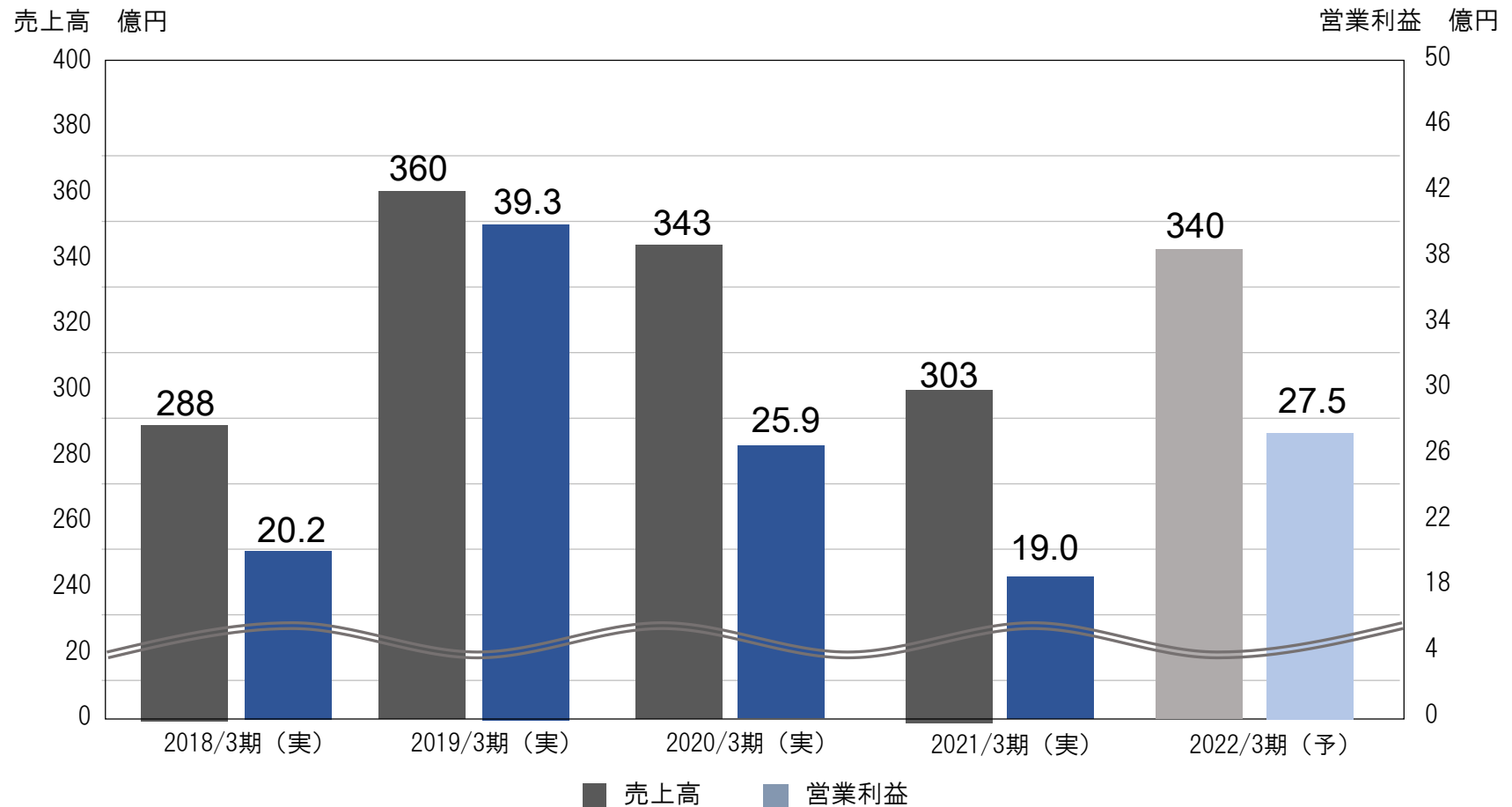
A faint, light gray world map is visible in the background of the slide, centered behind the text.

新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた計画ながら、
「安定した収益を確保できる企業」を目指す戦略の
方向性は不変

特に半導体関連を中心に追い風を受ける中、
来期以降にも繋がる戦略的設備投資などを目的とした
ファイナンスを実施

中期目標

新型コロナウイルス感染症の影響から中計最終年度の目標数字を修正
 売上高380億円を340億円、営業利益46億円を27.5億円、営業利益率12%を8%に



営業利益率目標 12% → 8%

安定した収益を 確保できる企業

ダウンサイドに強い
安定した
収益基盤の強化

持続的成長のための
エンジン事業の育成

Okamotoブランドの再構築



顧客ライフタイムバリュー強化

B to B → B with B

サービス体制拡充、高付加価値機拡販

グローバル戦線拡充

マーケティング体制強化、管理体制強化

モノづくり改革

モノづくりの整流化、海外直送体制の確立

計画の更なる進捗を目的とした資金調達を実施

本新株予約権の行使の結果交付される当社普通株式には、全て当社の自己株式を充当する予定
 当社の発行済株式総数は増加しない（可及的速やかな調達を予定）

		第1回新株予約権
発行方法		大和証券株式会社に対する第三者割当
発行概要	行使期間	2021年9月28日～2024年9月27日
	想定調達額	4,429百万円（差引手取概算額）
	新株予約権個数	7,000個
	目的株式数	700,000株（対発行済株式数14.8%＊）
行使価額	当初行使価額	6,275円
	行使価額の修正	各行使請求の効力発生日の当社普通株式の終値の92%に相当する額
	上限行使価額	なし
	下限行使価額	4,092円
その他	付帯条項	行使停止条項 （当社の判断で新株予約権を行使できない期間を指定）
	取得条項	当社の判断で残存する新株予約権の取得・消却が可能
	譲渡制限	当社取締役会の事前の承認がない限り、本新株予約権を第三者に譲渡することはできない

＊ 対発行済株式数は2021年9月10日時点の発行済株式総数4,717,895株を基準に算出

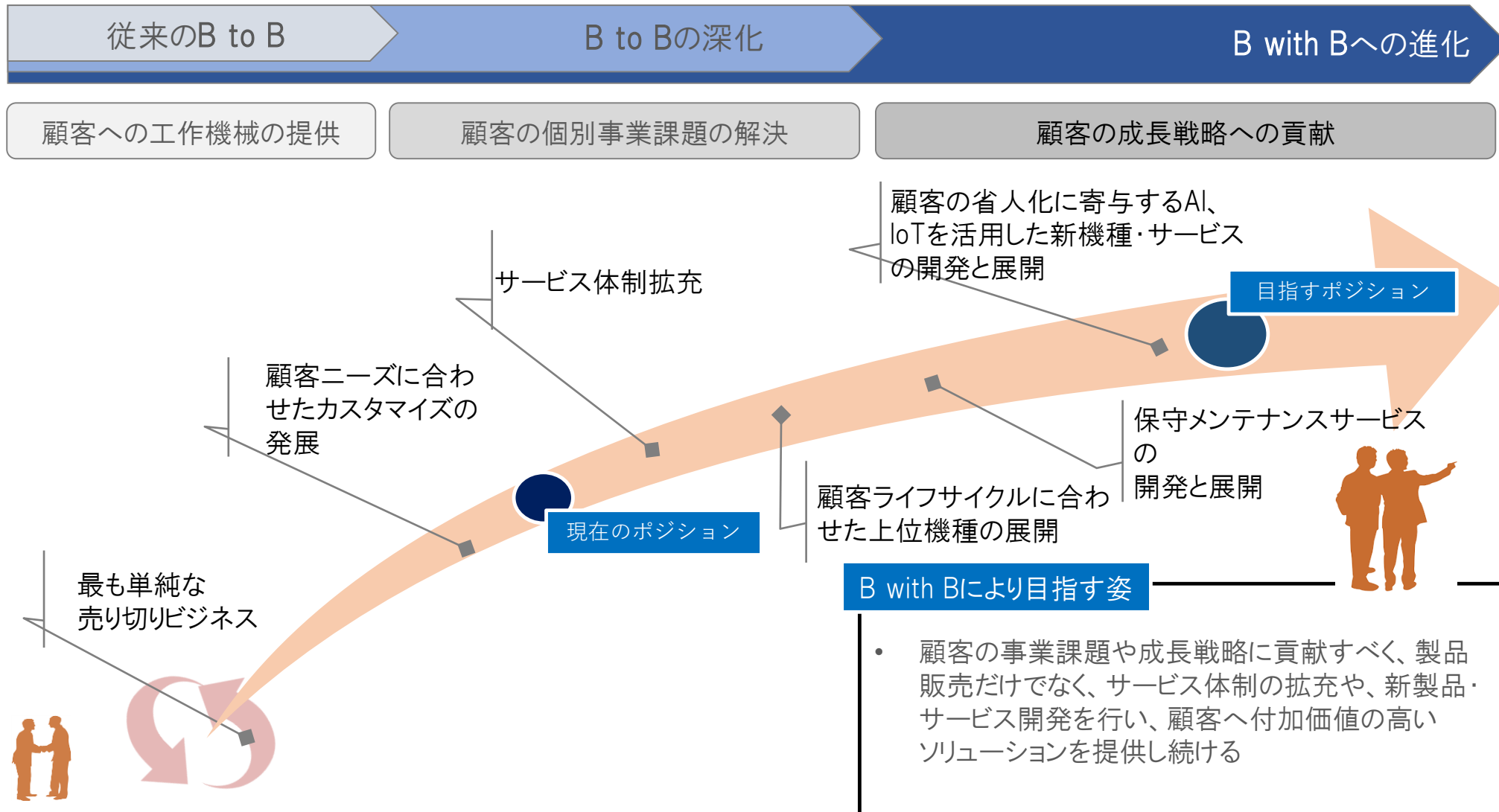
調達資金使途

- 資金使途は、
1. 生産能力向上に向けた設備投資及び中国子会社への投資資金
 2. 本社工場における自動倉庫の建設

財務安定性のさらなる向上を実現しつつ、生産能力の増強・生産性の向上に努め一層の企業価値向上を図る

	資金使途	資金調達の各資金使途の目的	金額	支出予定時期
1	工作機械及び半導体関連装置の生産能力向上に向けた生産設備の新設・更新のための設備投資資金及び中国子会社への投資資金	<ul style="list-style-type: none"> ・工作機械及び半導体関連装置事業ともに、更なる需要の拡大が見込まれ、特に、高精度な平面研削盤、及び半導体関連装置の生産拡大がより一層重要になる。これらの製造を中心とした生産能力の向上に直結する生産設備の新設及び更新のための設備投資を行い、生産体制の再構築と拡大する需要の最大限の取り込みを目指す ・具体的な施策として、本社工場である群馬県安中工場の生産設備の購入・更新とIT基幹システムの導入を実施。また、子会社投資を通じて、「岡本工機（常州）有限公司」（中国）における生産工場の建設に着手し、工作機械の国外での生産エリアの拡大と海外顧客への拡販にも同時に取り組む 	3,129百万円	2022年3月 ～2025年4月
2	工作機械及び半導体関連装置に関連するアフターサービス需要の拡大に対応するための自動倉庫の建設資金	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度を最終年度とする中期経営計画の基本戦略で掲げた顧客付加価値強化のためのサービス体制拡充に沿った自動倉庫の建設に取り組む。自動倉庫の建設により、サービスパーツ管理・供給体制の再構築を行い、部品納期の短縮化とアフターサービス対応力強化を図ること、顧客に対しより付加価値の高いソリューション提供を目指す 	1,300百万円	2021年12月 ～2022年12月

顧客ライフタイムバリューの強化



自動倉庫建設について ①

➔ 3日以内のサービス対応

➔ リードタイムの短縮化



「具体的な目的と効果」

1) 生産性・作業効率向上

- ◆入/出庫、及びピッキング作業の自動化によりヒューマンエラーが削減され、生産性が飛躍的に向上
- ◆夜間の自動/無人稼働により、翌日以降の品揃え作業における省力化が可能に
- ◆棚卸作業の高効率化

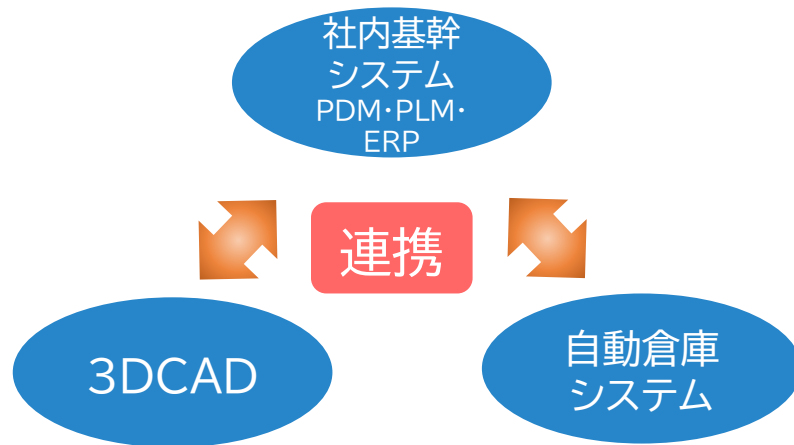
2) 省スペース化

- ◆高層のラック化によって高さ方向の有効利用が可能となり、保管場所の省スペース化に貢献

3) 業務品質と製品品質の安定化

- ◆人力の場合とは異なり、作業量に関わらず一定の品質で作業が行われるため、業務品質が安定
- ◆空調により庫内温度を一定に保つことにより、部品品質が安定
- ◆社内基幹システムとの連携により、正確な入/出庫・在庫管理が実現

自動倉庫建設について ②

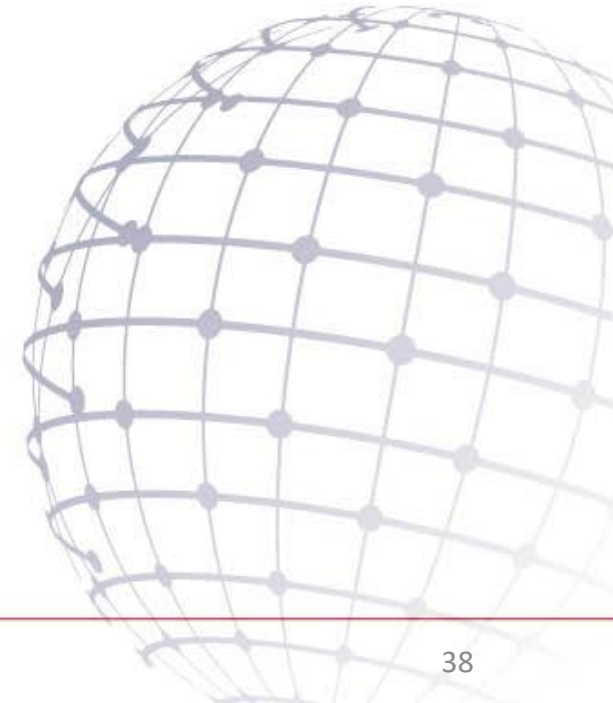


同時に刷新される各種社内基幹システムにより

- ◆あらゆる製品情報の一元管理と全社的な共有化
- ◆ペーパーレス化
- ◆省力化

を実現しつつ、これに自動倉庫を連携させることによって
今後の生産性改革を加速度をもって推進させるツールとしての整備を図る

6. EV関連領域での当社製品の役割



EVカーの部品構成とEVモーター

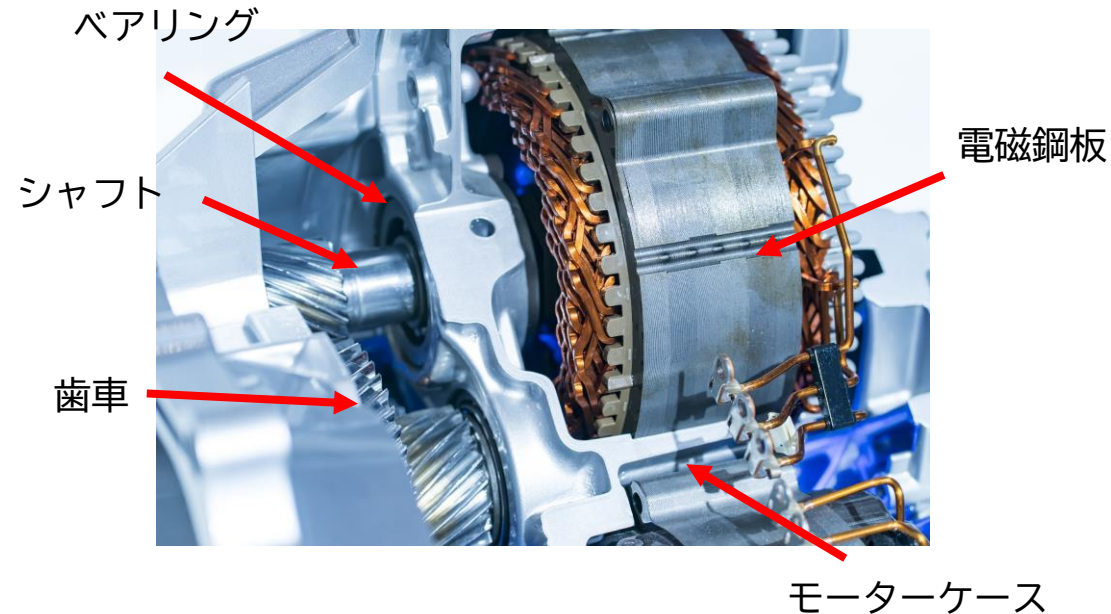
EVカーの部品構成



【新規構成部品】

- ・ EVモーター
- ・ バッテリー
- ・ シャフト
- ・ 歯車
- ・ ベアリング
- ・ 半導体

EVモーター

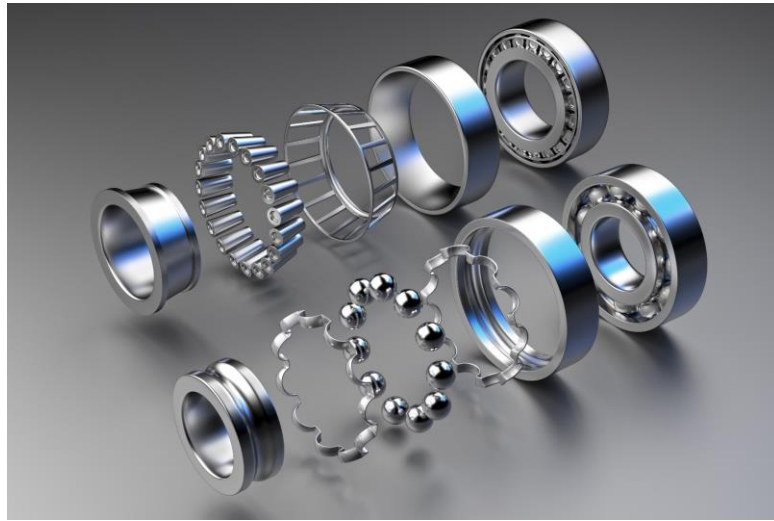


名称：EVモーター
 【研削部品】
 電磁鋼板(モーターコア)
 ベアリング
 歯車
 モーターケース

【対象機種】
 ・ 平面研削盤
 ・ 円筒研削盤
 ・ 内面研削盤
 ・ ロータリー研削盤
 ・ 歯車研削盤

ベアリングの研削、バッテリーの研削

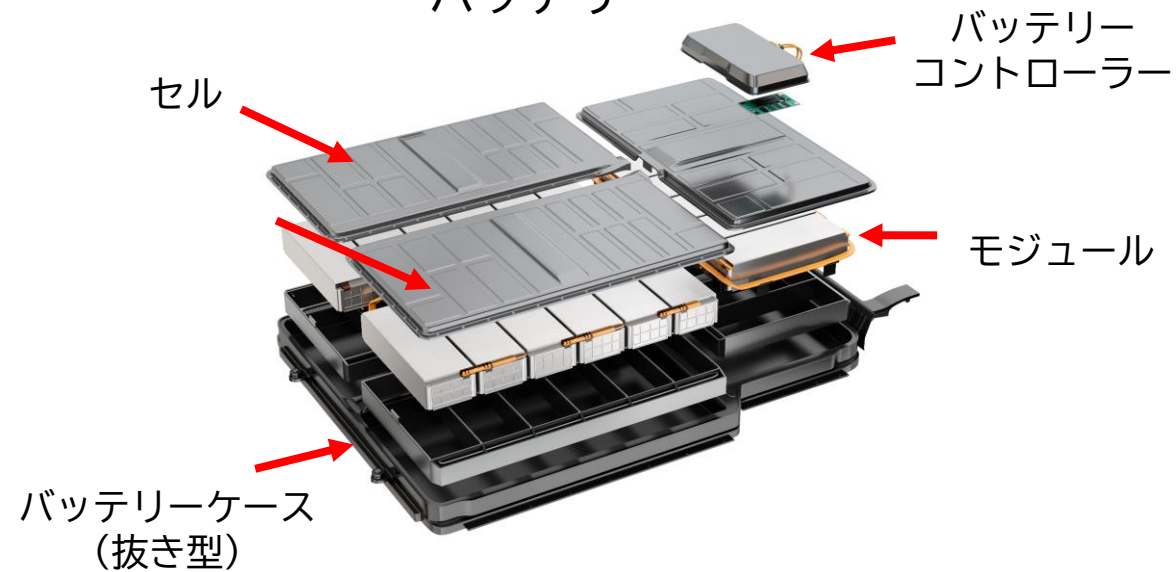
ベアリング



名称：ベアリング
【研削部品】
スペーサー
リング

【対象機種】
・平面研削盤
・円筒研削盤
・内面研削盤
・ロータリー研削盤

バッテリー

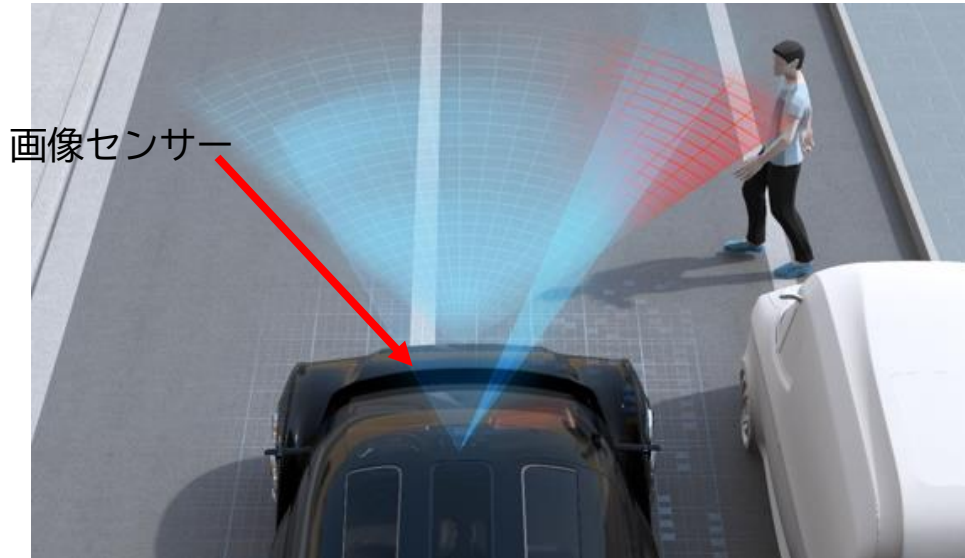


名称：バッテリー
【研削部品】
バッテリー用塗工装置部品(Tダイ)
ケース金型
ゴム金型

【対象機種】
・平面研削盤

自動運転用車外センサー、自動運転用車内システム

自動運転用車外センサー



名称：自動運転用車外センサー

【研削部品】
電子部品金型

【対象機種】

- ・平面研削盤
- ・成形研削盤

自動運転用車内システム



名称：自動運転用車内システム

【研削部品】
電子金型部品
各種半導体

【対象機種】

- ・平面研削盤
- ・成形研削盤
- ・半導体関連製造装置

EV用パワー半導体、組立ライン

EV用パワー半導体



名称：EV用パワー半導体

【対象機種】

・半導体関連製造装置

【研削部品】

ウエーハ

(シリコン・SiC・GaN)

EV用ロボット組立ライン



名称：EV用組立ロボットライン

【対象機種】

・歯車研削盤
・ロータリー研削盤
・各種当社事業

【研削部品】

歯車

鋳物

Appendix

～ご参考資料～



世界唯一の総合砥粒加工機メーカー



会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	48億8051万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	【各種研削盤・半導体関連装置の製造・販売】 研削盤（平面・成形・円筒・内面・歯車・周辺機器） 半導体関連装置（グラインディング・ポリッシング・ラッピング・スライシング）
従業員数	連結：1,978名 単体：460名 ※2021年9月末現在



当社製品の役割 一般金型分野



平面研削盤



成形研削盤

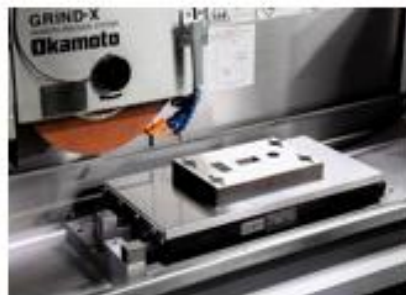


円筒研削盤

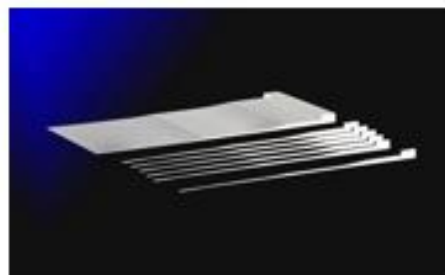


内面研削盤

▶▶ 金型プレート平面研削 ▶▶ ピン関係の成形研削



機械	精密平面研削盤 PSG64SA1
寸法	450×300mm
材質	SKD11 (HRC55)
精度	平面度 1.8 μm



機械	超精密成形研削盤 UPZ210LiII
品名	段付き角エジェクターピン
寸法	100×2×0.7mm
材質	SKH51 (HRC59~61)
精度	厚み0~0.002mm ソリ無きこと

▶▶ 金型



▶▶ パンチ関係の円筒研削 ▶▶ ダイ関係の内面研削



機械	CNC精密円筒研削盤 OGM350NC III
品名	金型パンチ
寸法	φ10×60mm
材質	G4 (HRA88~90)



機械	CNC精密内面研削盤 IGM15NC III
品名	内面コンタリングワーク
寸法	外径φ40×内径φ20×15mm
表面粗さ	Ra0.034 μm

当社製品の役割 スマートフォン分野



超精密平面研削盤
(静圧スライド仕様)

▶▶ レンズ金型平面 & 鏡面研削



機械	超精密平面研削盤 UPG63CA1
品名	スマホレンズ金型プレート
寸法	300 × 300mm
精度	平面度: 0.0005mm (0.5 μm)
	平行度: 0.001mm (1 μm)
	面粗度: Ra0.0019 μm

▶▶ 通信関連のウエハ研磨



機械	ファイナルポリッシャー PN X332B
品名	半導体ウエハ
寸法	φ150mm
材質	LT/LN

▶▶ スマートフォン完成



超精密プロファイル研削盤
(全軸リニアモータ駆動)

▶▶ コネクタ金型のピッチ研削



機械	超精密成形研削盤 UPZ210L II
品名	コネクタ
濃数	52本
材質	SKD11 (HRC56~58)
精度	累積ピッチ-1.7 μm



半導体関連製造装置
(グラインダー/ポリッシャー)

当社製品の役割 自動車関連分野



超精密門形研削盤



円筒研削盤



複合研削盤



半導体関連製造装置
(グラインダー/ポリッシャー)

モーターコア金型の平面研削



機械	超精密門形平面研削盤 UPG208CHL2
品名	モーターコア用プレス金型
寸法	600 × 400 × 80mm
精度	平面度: 2.2 μm
	面粗度: Ra0.06 μm



車載半導体関連のウエハ研磨



機械	ファイナルポリッシャー PNX332B
品名	半導体ウエハ
寸法	φ300mm
材質	Si/SiC



塗工装置部品



ベアリング内面&平面



高精度歯車研削



各種自動運転センサーの金型



当社製品の役割 工作機械・精密加工分野



超精密門形研削盤

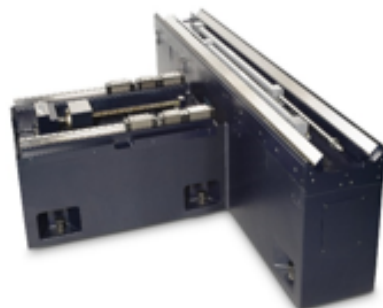
超精密ベッド研削盤
(写真は10000×3500mm仕様)

精密内面研削盤

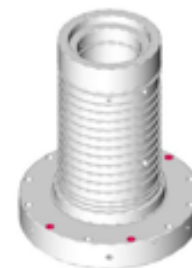


立型複合研削盤

工作機械フレームの摺動面研削 ▶▶ 精密スピンドルの内外研削



機械	CNC超精密ベッド研削盤 UDG10035NC
品名	工作機械フレーム
寸法	1500×1000×400
材質	FC200
寸法精度	±3 μm以内



機械	立型複合円筒研削盤 UGM5V
品名	スピンドルケース
寸法	φ200mm L=342mm
材質	FC300
精度	真円度外径:0.4 μm 円筒度外径:1.5 μm

各種ツール保持関係の内外研削 ▶▶ 測定装置用定盤関係の平面研削

機械	内面研削盤 IGM15NCⅢ
品名	ツールホルダー
寸法	外径φ50×内径φ30×L120mm
材質	超硬コーティング
精度	真円度外径:1 μm以内 同軸度:1.5 μm以内



機械	CNC超精密門形平面研削盤UPG208 CHLi
品名	セラミックス定盤
寸法	800×400×100mm
材質	アルミナセラミックス
精度	平面度2 μm以内 Ra0.1 μm

当社製品の役割 その他・部品加工関連

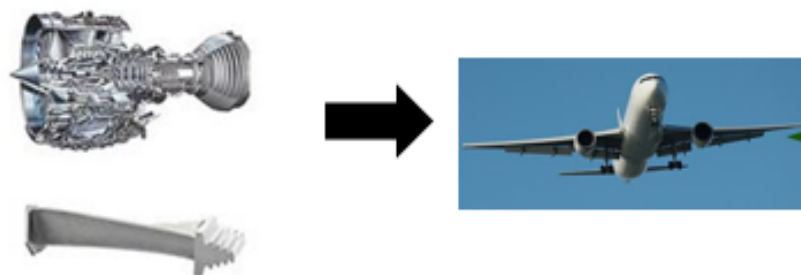
▶▶ 圧延ロール研削

機械	CNC精密円筒研削盤 OGM350NCⅢ
品名	圧延ロール
寸法	φ90 × 100mm
材質	M70
表面粗さ	Ra0.036 μm
形状精度	0.87 μm

▶▶ 各種歯車の平面部研削

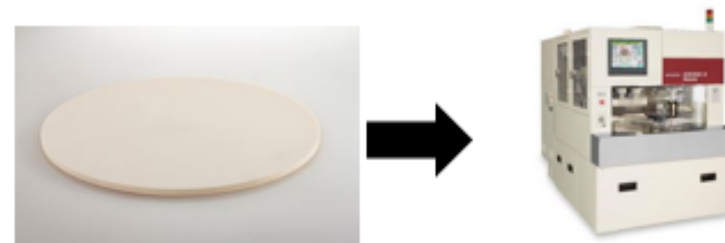
機械	CNC精密ロータリ研削盤PRG8DXNC
品名	ギア
材質	SKD-1
寸法	φ90 × 複数個
精度	平面度: 2.4 μm
	複数個の寸法バラツキ: ±2 μm以内

▶▶ タービンブレードの研削



機械	専用研削盤
品名	タービンブレード

▶▶ 各種セラミックスの研削 (半導体関連製造装置向け)



機械	CNC精密ロータリ研削盤PRG8DXNC
品名	半導体製造部品関係
材質	アルミナセラミックス
寸法	φ300
精度	平面度: 2.1 μm
サイクルタイム	除去量0.1mm 90秒



本資料に関するお問い合わせ先

株式会社 岡本工作機械製作所
総務部
TEL 027(385)5800

【本資料お取扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。